

2005年10月28日

2006年3月期 中間決算説明会

東京エレクトロン デバイス株式会社



TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED

2006年3月期 中間期 業績

(単位:百万円)

科 目	05/3期		06/3期		(参考) 増減率 (%)	06/3期		増減率 (%)
	中間単体	(%)	中間連結	(%)		中間単体	(%)	
売上高	46,018	100.0	42,622	100.0	7.4	42,550	100.0	7.5
売上総利益	6,115	13.3	5,579	13.1	8.8	5,547	13.0	9.3
営業利益	1,758	3.8	1,438	3.4	18.2	1,457	3.4	17.1
経常利益	1,486	3.2	1,218	2.9	18.0	1,233	2.9	17.0
中間純利益	866	1.9	716	1.7	17.3	727	1.7	16.0
1株当たり 中間純利益	9,417.47円		7,790.37円			7,908.55円		
R O E	13.2%				10.0%			10.1%
従業員数	552人				563人			556人

注)05/3期中間単体と06/3期中間連結の比較も記載しております。

2006年3月期 中間期 資 産

(単位:百万円)

科 目	05/3期 中間単体	06/3期 中間連結	(参考) 増減額	06/3期 中間単体	増減額
現預金	948	1,110	161	1,099	150
受取手形・売掛金	18,034	22,699	4,664	22,618	4,583
たな卸資産	13,249	12,457	791	12,044	1,204
その他流動資産	844	694	149	689	154
有形固定資産	368	743	374	743	374
無形固定資産	293	201	92	201	92
投資その他の資産	2,215	1,404	811	1,446	768
資産計	35,955	39,311	3,355	38,843	2,887

注) 05/3期中間単体と06/3期中間連結の比較も記載しております。

2006年3月期 中間期 負債・資本

(単位:百万円)

科 目	05/3期 中間単体	06/3期 中間連結	(参考) 増減額	06/3期 中間単体	増減額
買掛金	7,996	11,772	3,776	11,369	3,372
短期借入金	1,000	5,084	4,084	5,000	4,000
その他流動負債	2,299	1,936	363	1,925	374
長期借入金	8,000	3,000	5,000	3,000	5,000
その他固定負債	3,263	2,902	360	2,902	360
負債計	22,560	24,697	2,137	24,197	1,637
資本金	2,495	2,495	-	2,495	-
資本剰余金	2,054	2,054	-	2,054	-
利益剰余金	8,845	10,061	1,216	10,095	1,250
為替換算調整勘定	-	2	2	-	-
資本計	13,395	14,614	1,218	14,645	1,250
負債・資本計	35,955	39,311	3,355	38,843	2,887

注) 05/3期中間単体と06/3期中間連結の比較も記載しております。

2006年3月期 中間期 キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

科 目	05/3期 中間単体	06/3期 中間連結	(参考) 増減額	06/3期 中間単体	増減額
営業キャッシュ・フロー	2,663	511	2,152	631	2,031
投資キャッシュ・フロー	127	136	9	136	9
財務キャッシュ・フロー	2,227	193	2,033	276	1,951
現金等の増減額	310	183	127	220	89

注)05/3期中間単体と06/3期中間連結の比較も記載しております。

2006年3月期 中間期 品目別売上高

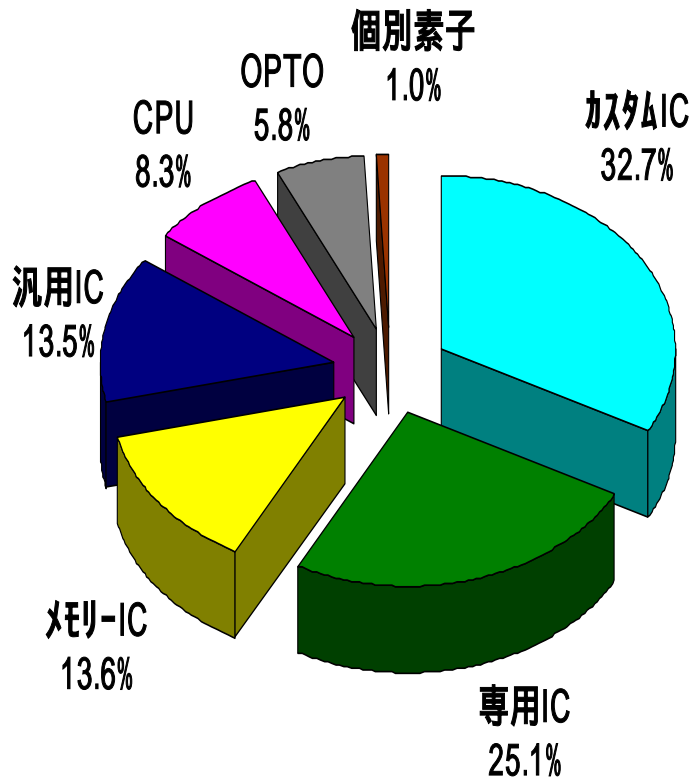
(単位:百万円)

品 目	05/3期 中間単体		06/3期 中間連結		06/3期 中間単体	
	売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)
半導体製品	40,960	89.0	37,577	88.2	37,505	88.1
ボード製品	2,252	4.9	1,891	4.4	1,891	4.5
ソフトウェア	1,394	3.0	1,488	3.5	1,488	3.5
一般電子部品	1,411	3.1	1,665	3.9	1,665	3.9
合 計	46,018	100.0	42,622	100.0	42,550	100.0

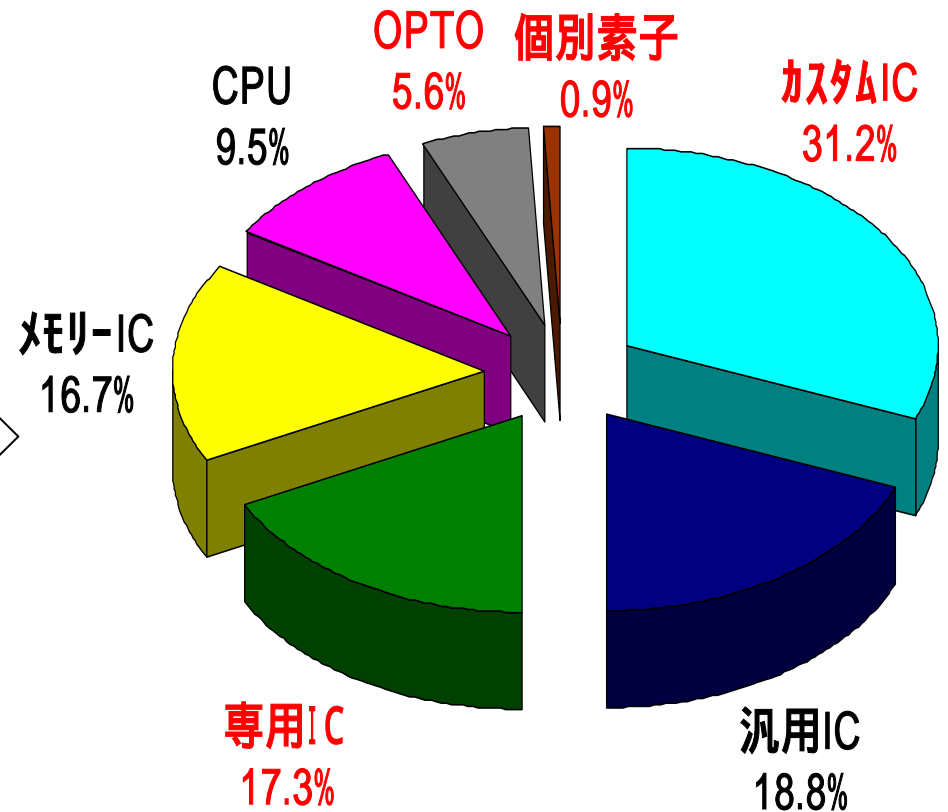
* 品目についての説明は、巻末をご参照ください。

2006年3月期 中間期 半導体製品売上構成比

< 2005/3期 中間 単体 >



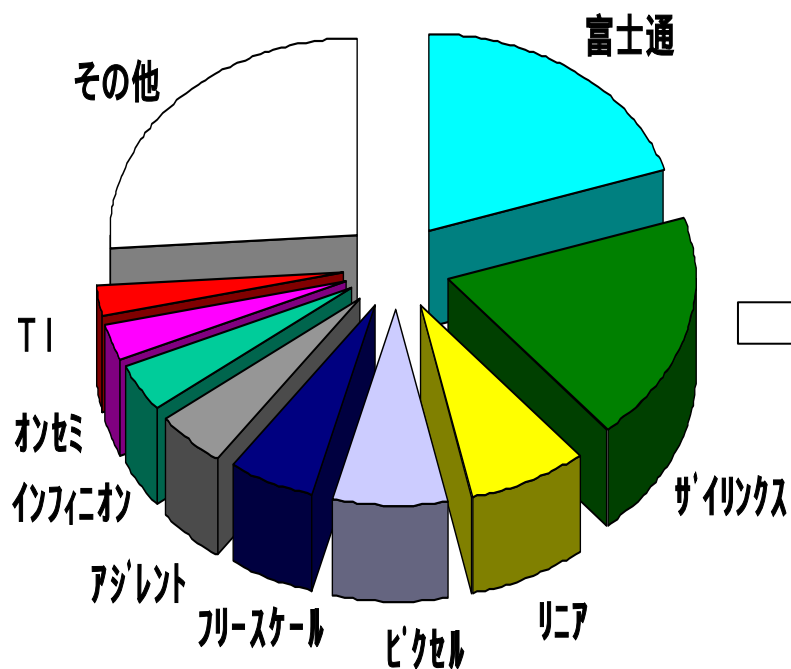
< 2006/3期 中間 連結 >



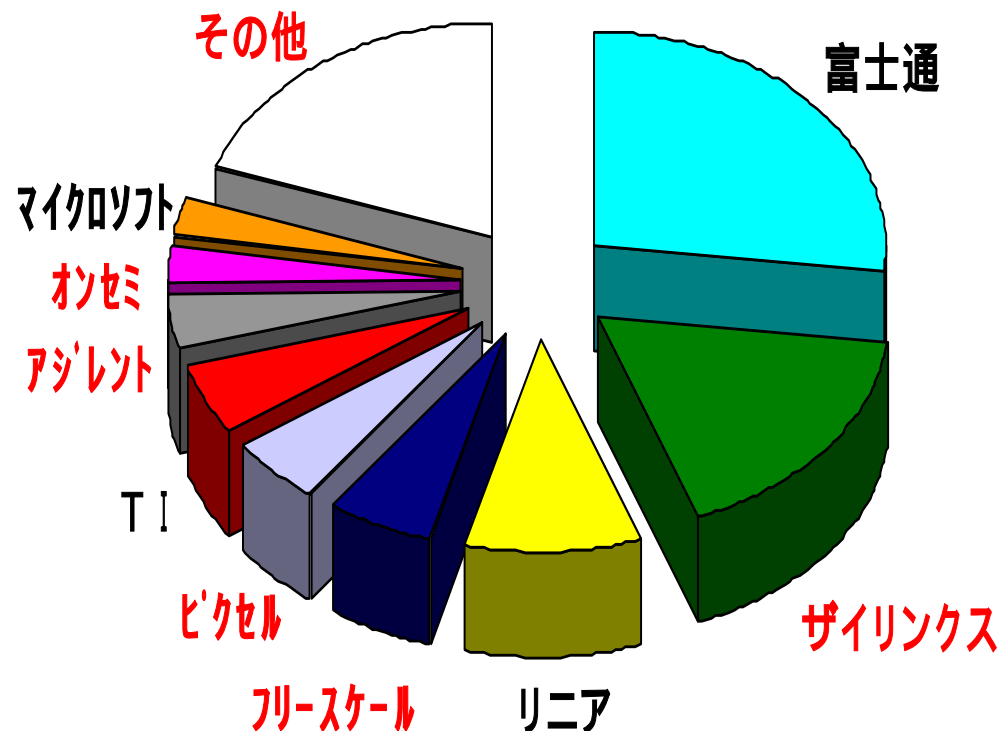
* 品目についての説明は、巻末をご参照ください。

2006年3月期 中間期 商品別売上構成比

< 2005/3期 中間 単体 >



< 2006/3期 中間 連結 >



注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

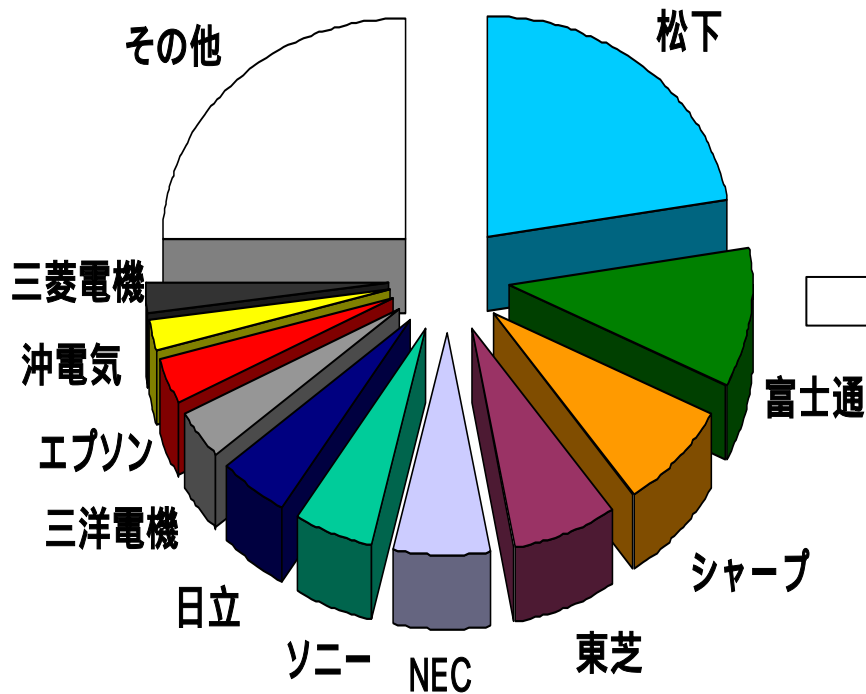
2006年3月期 中間期 主要商品別売上高増減

仕入先名	前年同期比増減率 (前期単体:今期連結)
富士通(株)	23%
ザイリンクス社	16%
リニアテクノロジー社	14%
フリースケール・セミコンダクタ社	10%
ピクセルワークス社	34%
T I 社	86%
開発ビジネス	4%
全社計	7.4%

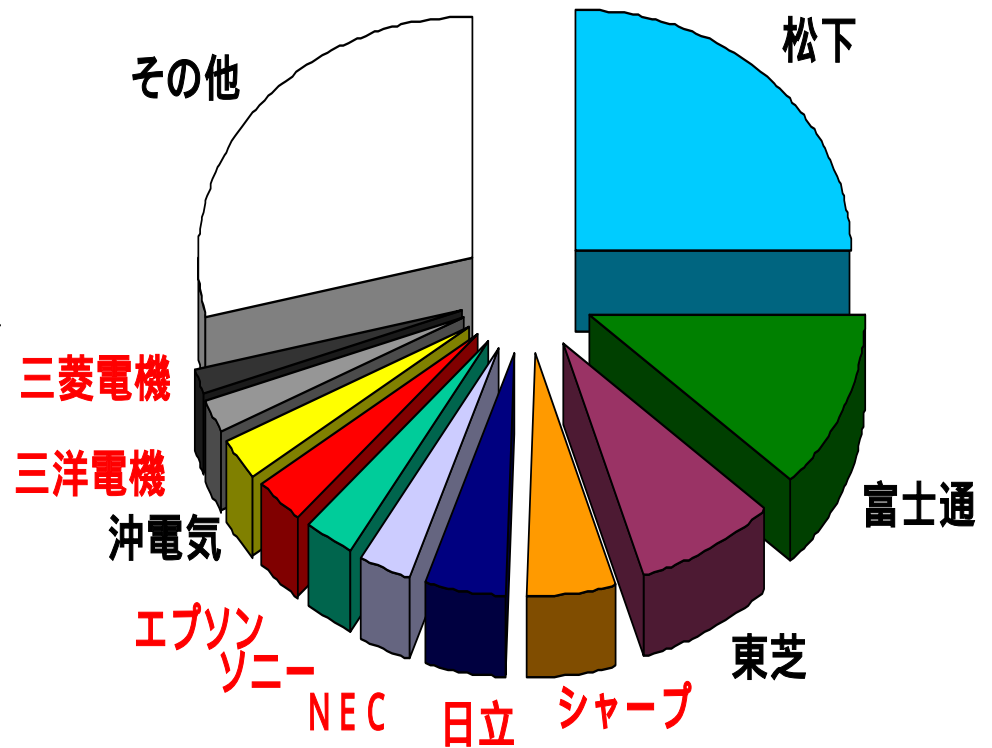
上記売上高は、各仕入先の業績には連動いたしません。

2006年3月期 中間期 顧客別売上構成比

< 2005/3期 中間 単体 >



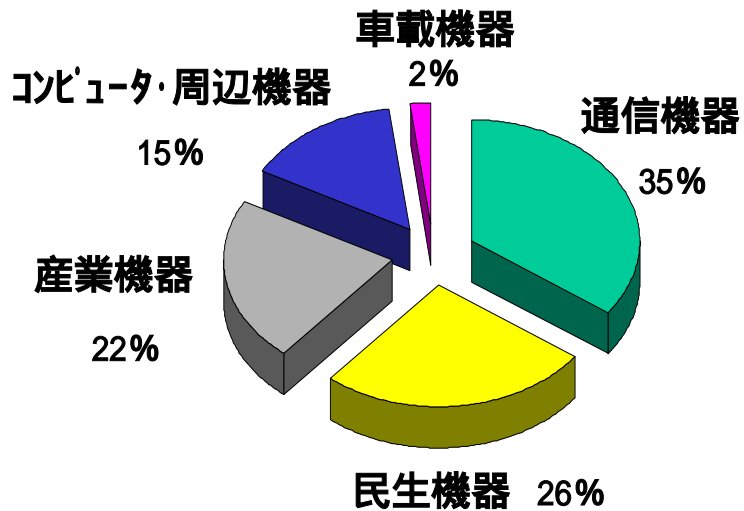
< 2006/3期 中間 連結 >



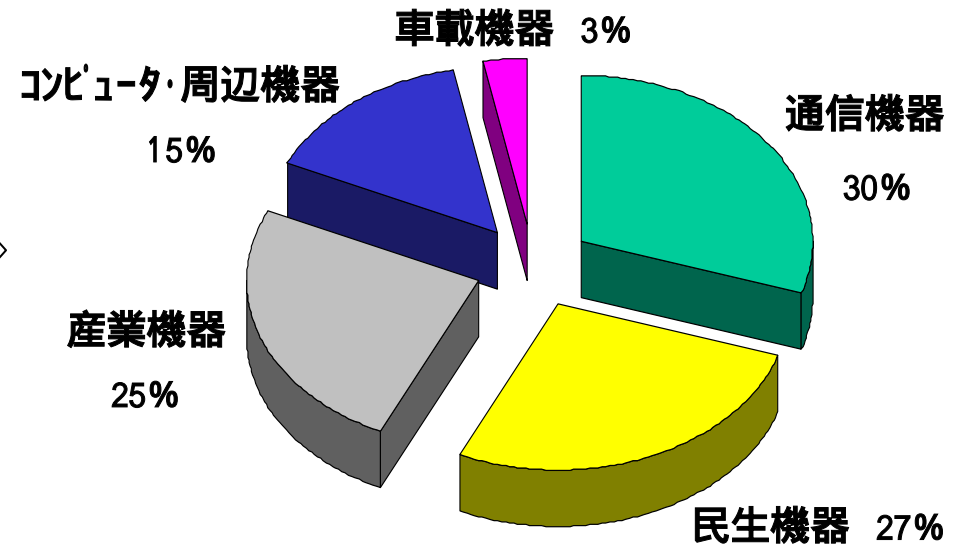
注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

2006年3月期 中間期 用途別売上構成比

< 2005/3期 中間 単体 >



< 2006/3期 中間 連結 >

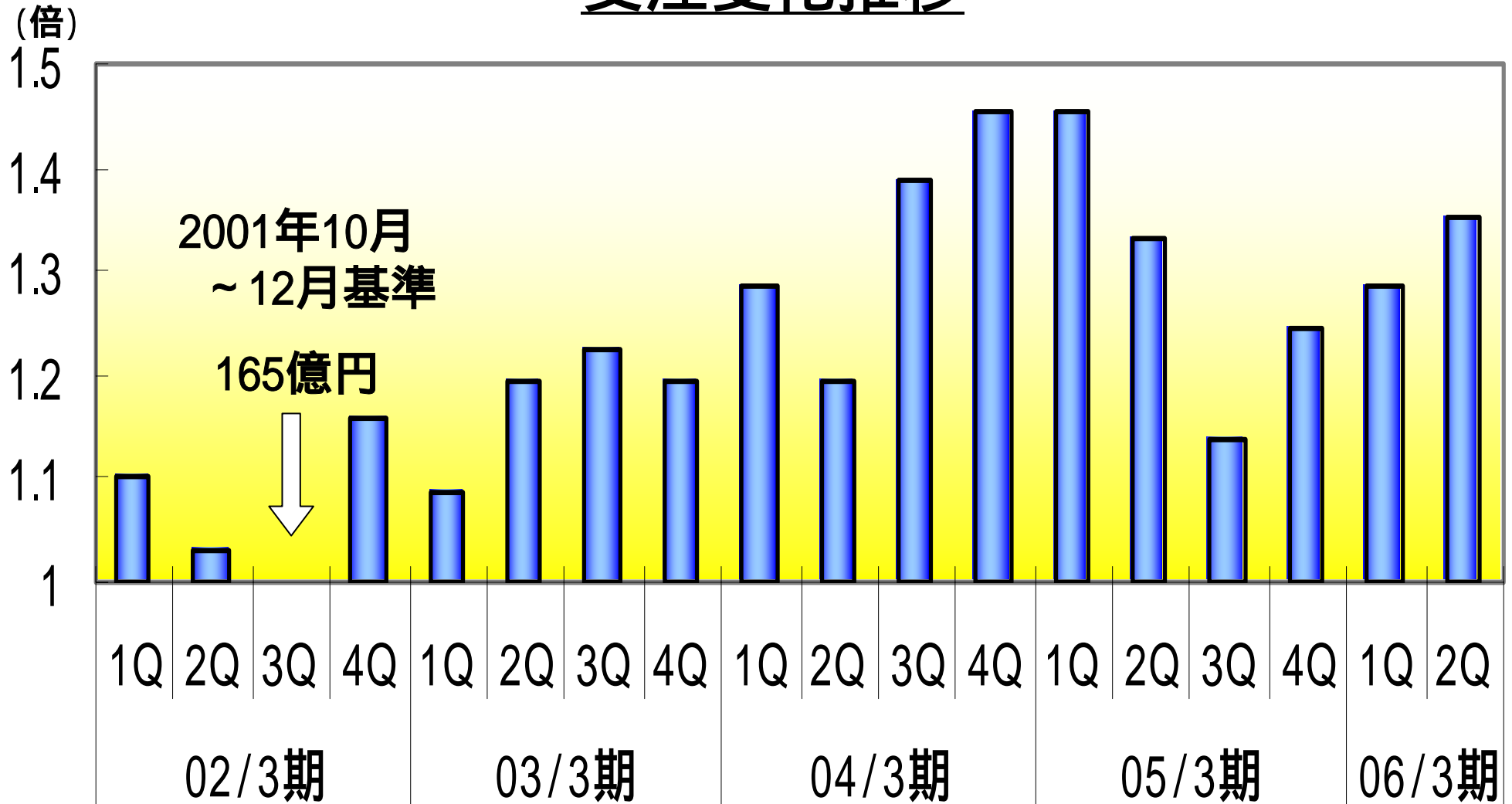


用途	主なアプリケーション
通信機器	ターミナルアダプタ、ケーブルモデム、携帯電話、ルーター、交換機、基地局
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、チューナー、液晶TV、プラズマTV、DVD
産業機器	セキュリティ監視機器、医療機器、放送機器、テスター、半導体製造装置
コンピュータ・周辺機器	プリンター、プロジェクター、POS、PC、ワークステーション、汎用コンピュータ
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ

今期の業績予想について



受注变化推移



* 06/3期は、連結受注高を記載しております。

2006年3月期 主要商品売上高増減見込み

仕入先名	通期見込み増減率 (前期単体:今期連結)
富士通(株)	12%
ザイリンクス社	1%
リニアテクノロジー社	19%
フリースケール・セミコンダクタ社	10%
ピクセルワークス社	26%
TI社	63%
開発ビジネス	±0%
全社計	2.4%

上記売上見込みは、各仕入先の業績には連動いたしません。

2006年3月期 連結業績予想

(単位:百万円)

科目	2005年3月期 単体	2006年3月期 連結予想	通期対前年 増減率
売上高	88,079	86,000	2.4%
経常利益	2,820	2,870	1.8%
当期純利益	1,916	1,670	12.9%
1株当たり当期純利益	20,597.25円	18,152.17円	
1株当たり配当金	5,500円	6,000円	
R O E	14.2%	11.3%	

中期の課題

マーケティング

顧客要求の商品/ビジネスモデルへの対応

収益の確保

安定した利益成長の実現

収益率の向上

開発ビジネスの成長

今期の活動方針

東京エレクトロン デバイス香港の立上げ

- 今期売上計画42億円

新規顧客の開拓

- 高付加価値商品の販売促進

開発ビジネス

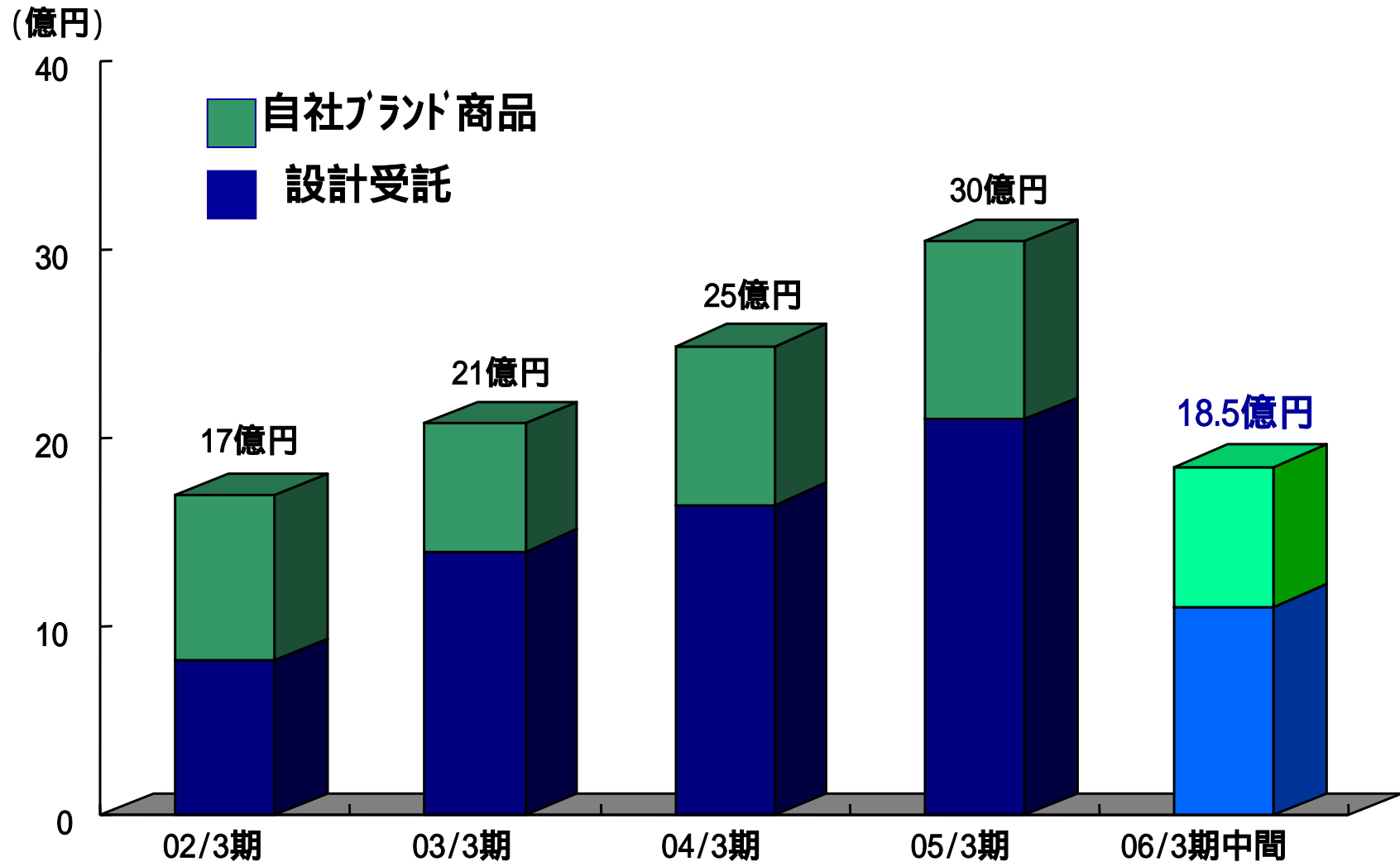
- 設計受託業務の受注拡大
- 自社ブランド商品のマーケティングの推進

開発ビジネスについて

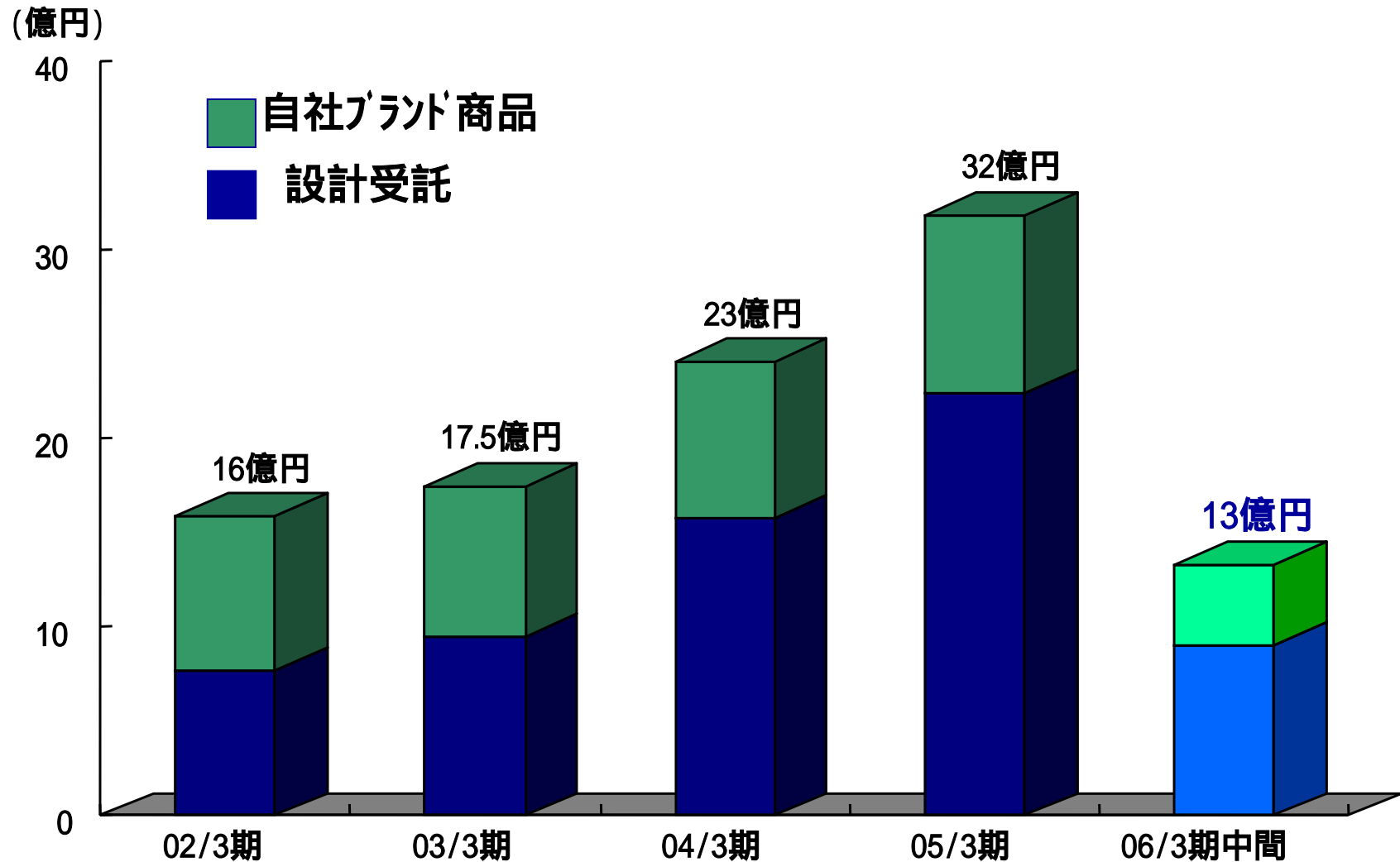
inrevium
(インレビウム)



開発ビジネス 受注高推移



開発ビジネス 売上高推移



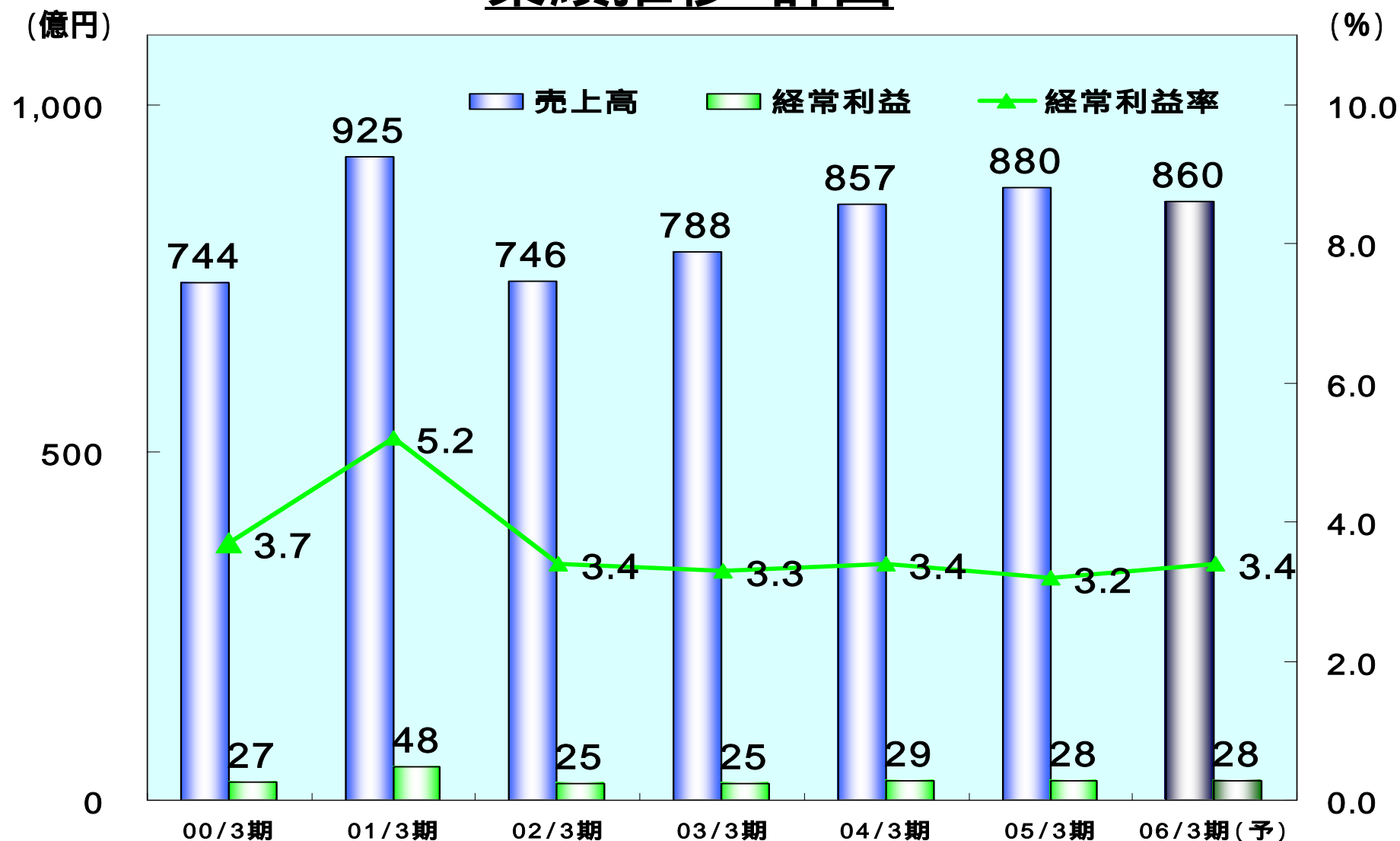
資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。

業績推移・計画



用語説明(1)

半導体製品	主な取扱商品	機能
カスタムIC	ASIC(富士通株) PLD(サイリンクス社)	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
メモリIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	演算機能、電子機器の頭脳
OPTO	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用するIC
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品

用語説明(2)

<p>ボード製品</p>		<p>プリント配線基板の上にIC、電源、コネクタなどの部品を実装した製品で、産業機器などに組み込まれる</p>
<p>ソフトウェア</p>		<p>マイクロソフト社の産業機器に組み込まれるOSを中心に販売(PC用以外)</p>
<p>一般電子部品</p>		<p>機器間を接続するコネクタやケーブル、液晶表示部品、電源など、電子機器には不可欠な周辺部品</p>